



Title of Change:	Capacity Expansion of Assembly and Test operations of ON Semiconductor Cebu for SSOT6 package to ON Semiconductor Seremban, Malaysia.
Proposed First Ship date:	30 Oct 2020 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Rafidah.MohdRasid@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected parts from ON Semiconductor Seremban, Malaysia will be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.
Change Category:	Assembly Change, Test Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition, Material Change, Shipping/Packaging/Marking

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None

Description and Purpose:

This Product Change Notification is to announce that ON Semiconductor is expanding Assembly and Test Operations of Cebu former Fairchild Semiconductor for SSOT6 package to ON Seremban, Malaysia.

- No change on existing OPN. There will be two separate BOMs for ON Cebu, Philippines and ON Seremban, Malaysia. ON Seremban.
- Marking date code & Tape/Reel & Label follow with ON Semiconductor standard format.
- Case Outline is compatible with existing SSOT6 solder footprint.
- These products will continue being Pb-free, Halide free and RoHS compliant. Qualification tests are designed to show that the reliability of the impacted devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standard.

	Before Change Description	After Change Description	
Assembly & Test Site	ON Cebu, Philippines	ON Cebu, Philippines	ON Seremban, Malaysia
Die Attach	Eutectic DA	Eutectic DA	Eutectic DA
Mold Compound	CK5000A	CK5000A	G600FB
Case Outline	419BL	Refer below	
Product marking change	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format	



Case Outline Before and After Change Description:

Dim (mm)	Before			Dim (mm)	After		
	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max
A	0.90	1.00	1.10	A	0.90	1.00	1.10
A1	0.00	0.05	0.10	A1	0.00	0.05	0.10
A2	0.70	0.85	1.00	A2	0.70	0.85	1.00
A3	0.25 BSC			A3	0.25 BSC		
b	0.30	0.40	0.50	b	0.25	0.38	0.50
c	0.08	0.14	0.20	c	0.10	0.18	0.26
D	2.80	2.90	3.00	D	2.80	2.95	3.10
d	0.30 REF			d	0.30 REF		
E	2.60	2.80	3.00	E	2.50	2.75	3.00
E1	1.50	1.60	1.70	E1	1.30	1.50	1.70
e	0.95 BSC			e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC			e1	1.90 BSC		
L1	0.60 REF			L1	0.60 REF		
L2	0.35	0.45	0.55	L2	0.20	0.40	0.60
e	0°	---	8°	e	0°	---	10°

Qualification Plan:

QV DEVICE NAME : FDC5612

RMS: F54344

PACKAGE: TSOT-23-6

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

**QV DEVICE NAME : NDC7002N****RMS: F58116****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

QV DEVICE NAME : FDC3601N**RMS: F58114 & F65904****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

QV DEVICE NAME : NDC7001C**RMS: F59214****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

**QV DEVICE NAME : FDC6326L****RMS: F58803****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

QV DEVICE NAME : FDC6327C**RMS: F57950****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

QV DEVICE NAME : FDC6331L**RMS: F58796****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

**QV DEVICE NAME : FDC6333C****RMS: F57949****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

QV DEVICE NAME : FDC653N**RMS: F58339****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

QV DEVICE NAME : NDC7003P**RMS: F58087****PACKAGE: TSOT-23-6**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

Estimated date for qualification completion: 31 May 2020

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDC602P	FDC5612
FDC604P	FDC5612
FDC606P	FDC5612
FDC6301N	NDC7002N
FDC6302P	NDC7002N
FDC6303N	NDC7002N
FDC6304P	NDC7002N
FDC6305N	FDC3601N
FDC6306P	FDC3601N
FDC658AP	FDC5612
FDC658P	FDC5612
SI3457DV	FDC5612
FDC2512	FDC5612
FDC2612	FDC5612
FDC3512	FDC5612
FDC3601N	FDC3601N
FDC3612	FDC5612
FDC5612	FDC5612
FDC5612-G	FDC5612
FDC5614P	FDC5612
FDC5614P-G	FDC5612
NDC7001C	NDC7001C
NDC7002N	NDC7002N
NDC7003P	NDC7003P
FDC6310P	FDC3601N
FDC6312P	FDC3601N
FDC6318P	FDC3601N
FDC6320C	NDC7001C
FDC6321C	NDC7002N



FDC6323L	FDC6326L
FDC6324L	FDC6326L
FDC6325L	FDC6326L
FDC6326L	FDC6326L
FDC6327C	FDC6327C
FDC6329L	FDC6326L
FDC6330L	FDC6326L
FDC6331L	FDC6331L
FDC6333C	FDC6333C
FDC634P	FDC5612
FDC637AN	FDC5612
FDC638P	FDC5612
FDC6401N	FDC3601N
FDC640P	FDC5612
FDC6420C	FDC6333C
FDC645N	FDC5612
FDC6506P	FDC3601N
FDC653N	FDC653N
FDC654P	FDC5612
FDC6561AN	FDC3601N

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23031X

発行日: 06 May 2020

変更件名:	オン・セミコンダクター・セブの SSOT6 パッケージの組立 & テストオペレーションの能力を以下に拡張: オン・セミコンダクター・セレンバン (マレーシア)。
初回出荷予定日:	30 Oct 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Maricel.Escobedo@onsemi.com > にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	オン・セミコンダクター・セレンバン (マレーシア) からの影響を受ける部品は、オン・セミコンダクターの表示フォーマットに従う製品表示により識別できます。
変更カテゴリ:	アセンブリの変更, 試験の変更
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加, 材料の変更, 出荷/パッケージング/表記

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	なし

説明および目的:

本製品変更通知は、オン・セミコンダクターが、以前のフェアチャイルドセミコンダクターでのセブの SSOT6 パッケージの組み立ておよびテストオペレーションの能力を、オン・セレンバン(マレーシア)に拡張する内容をお知らせするものです。

- 既存の OPN に加えられる変更はありません。BOM は、オン・セブ (フィリピン) 用の一つ、そしてオン・セレンバン (マレーシア) 用の一つ、個別に存在することになります。オン・セレンバン。
- 表示日付コードとテープ/リールとラベルは、オン・セミコンダクターの標準フォーマットに従います。
- ケース外形は既存の SSOT6 はんだフットプリントに適合します。
- これらの製品は継続して鉛フリー、ハロゲン化合物フリーであり、RoHS に準拠しています。品質試験は、影響を受けるデバイスの信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを証明するように設計されています。

	変更前の表記	変更後の表記	
組み立て拠点 - テスト拠点	ON Cebu, Philippines	ON Cebu, Philippines	ON Seremban, Malaysia
ダイ接着剤材料	Eutectic DA	Eutectic DA	Eutectic DA
モールド・コンパウンド	CK5000A	CK5000A	G600FB
ケース外形	419BL	以下を参照してください	
製品表示変更	Ex-FCS Format	オン・セミコンダクターフォーマット	



変更前および変更後のケース外形の表記:

Dim (mm)	Before			Dim (mm)	After		
	Min	Nom	Max		Min	Nom	Max
A	0.90	1.00	1.10	A	0.90	1.00	1.10
A1	0.00	0.05	0.10	A1	0.00	0.05	0.10
A2	0.70	0.85	1.00	A2	0.70	0.85	1.00
A3	0.25 BSC			A3	0.25 BSC		
b	0.30	0.40	0.50	b	0.25	0.38	0.50
c	0.08	0.14	0.20	c	0.10	0.18	0.26
D	2.80	2.90	3.00	D	2.80	2.95	3.10
d	0.30 REF			d	0.30 REF		
E	2.60	2.80	3.00	E	2.50	2.75	3.00
E1	1.50	1.60	1.70	E1	1.30	1.50	1.70
e	0.95 BSC			e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC			e1	1.90 BSC		
L1	0.60 REF			L1	0.60 REF		
L2	0.35	0.45	0.55	L2	0.20	0.40	0.60
θ	0°	---	8°	θ	0°	---	10°

認定計画:

デバイス名: FDC5612

RMS: F54344

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	



デバイス名 : NDC7002N

RMS: F58116

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

デバイス名 : FDC3601N

RMS: F58114 & F65904

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

デバイス名 : NDC7001C

RMS: F59214

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	



デバイス名 : FDC6326L

RMS: F58803

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

デバイス名 : FDC6327C

RMS: F57950

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

デバイス名 : FDC6331L

RMS: F58796

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	



デバイス名 : FDC6333C

RMS: F57949

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

デバイス名 : FDC653N

RMS: F58339

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

デバイス名 : NDC7003P

RMS: F58087

パッケージ: TSOT-23-6

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

Estimated date for qualification completion: 31 May 2020



影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDC602P	FDC5612
FDC604P	FDC5612
FDC606P	FDC5612
FDC6301N	NDC7002N
FDC6302P	NDC7002N
FDC6303N	NDC7002N
FDC6304P	NDC7002N
FDC6305N	FDC3601N
FDC6306P	FDC3601N
FDC658AP	FDC5612
FDC658P	FDC5612
SI3457DV	FDC5612
FDC2512	FDC5612
FDC2612	FDC5612
FDC3512	FDC5612
FDC3601N	FDC3601N
FDC3612	FDC5612
FDC5612	FDC5612
FDC5612-G	FDC5612
FDC5614P	FDC5612
FDC5614P-G	FDC5612
NDC7001C	NDC7001C
NDC7002N	NDC7002N
NDC7003P	NDC7003P
FDC6310P	FDC3601N
FDC6312P	FDC3601N
FDC6318P	FDC3601N
FDC6320C	NDC7001C
FDC6321C	NDC7002N
FDC6323L	FDC6326L
FDC6324L	FDC6326L



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23031X

発行日: 06 May 2020

FDC6325L	FDC6326L
FDC6326L	FDC6326L
FDC6327C	FDC6327C
FDC6329L	FDC6326L
FDC6330L	FDC6326L
FDC6331L	FDC6331L
FDC6333C	FDC6333C
FDC634P	FDC5612
FDC637AN	FDC5612
FDC638P	FDC5612
FDC6401N	FDC3601N
FDC640P	FDC5612
FDC6420C	FDC6333C
FDC645N	FDC5612
FDC6506P	FDC3601N
FDC653N	FDC653N
FDC654P	FDC5612
FDC6561AN	FDC3601N